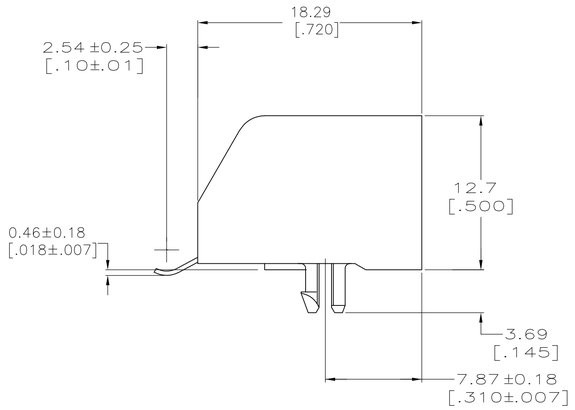
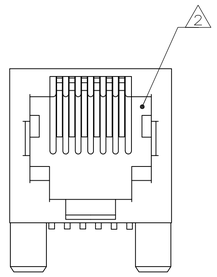
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

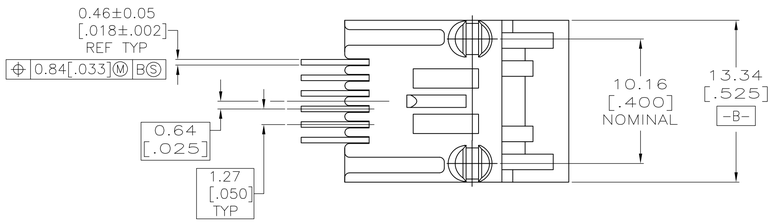
LOC	DIST
AA	00

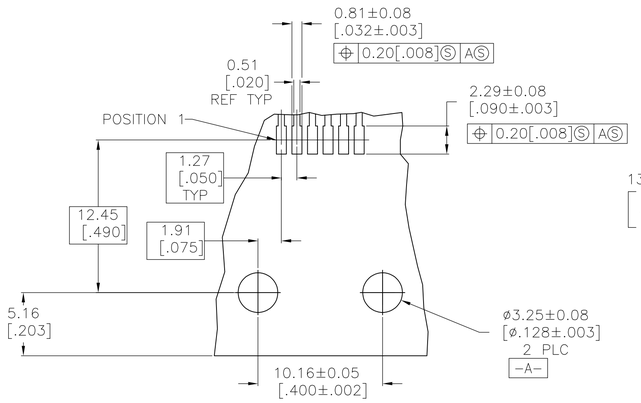
REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECO-11-005033	23MAR11	RK	HMR

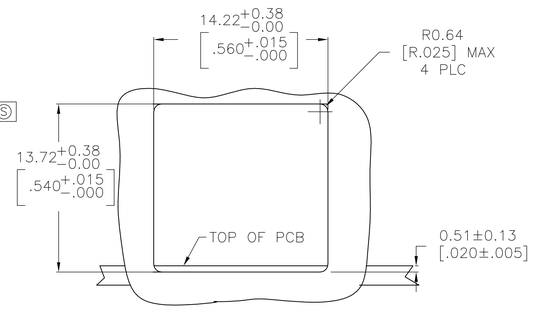








RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD
COMPONENT SIDE



RECOMMENDED
PANEL CUTOUT

1. MATERIAL: HOUSING– HTN MOLDING COMPOUND, 94VO, COLOR: BLACK.
TERMINAL– 0.36 [.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27µm [.000050] MIN THICK HARD GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA AND 3.81µm [.000150] THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27µm [.000050] MIN THICK NICKEL UNDERPLATE.

2. CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.

3. SNAP–IN RETENTION FEATURE ACCOMMODATES A 1.57±0.13 [.062±.005] PRINTED CIRCUIT BOARD.

4. DIMENSIONS ARE MAXIMUM UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AND ARE PRIOR TO SURFACE MOUNT PROCESSING.

5. TERMINALS SHALL BE ASSEMBLED IN CENTER POSITIONS FOR –2.

6. – 2 PACKAGED 42 ASSEMBLIES PER TUBE.

4 (5)	(6) 5557314–2
6	5557314–1 (SHOWN)
TERMINALS REQUIRED	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: SEE NOTE 1
FINISH: SEE NOTE 1

DWN L.A.MAYER 27AUG2007
CHK P.RECCE 27AUG2007
APVD S.FLICKINGER 27AUG2007
PRODUCT SPEC 108–1163
APPLICATION SPEC 114–8040
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME: MODULAR JACK ASSEMBLY, 6 POSITION, LOW PROFILE, RIGHT ANGLE, SURFACE MOUNT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C–5557314	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV B1

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9